

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月19日(19.05.2023)



(10) 国際公開番号

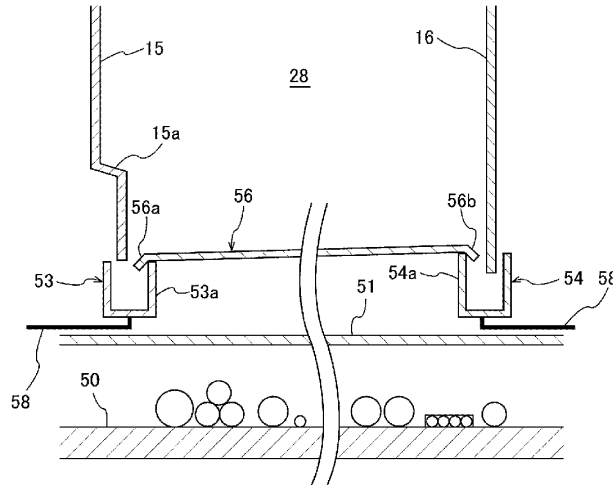
WO 2023/084977 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/037848
- (22) 国際出願日: 2022年10月11日(11.10.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-183078 2021年11月10日(10.11.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 谷澤 昭 尋 (YAZAWA, Akihiro); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 大橋 弘 亮 (OHASHI, Hirotaka); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 宮澤 康 之 (MIYASAWA, Yasuyuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理装置

[図2]



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing device that processes a substrate. A substrate processing device (10) that comprises: at least one first processing module (21a, 21b) that uses a fluid and processes a substrate W; at least one second processing module (31) that treats the substrate processed by the first processing module (21a, 21b); a conveying robot (22) that is disposed in a conveying area (28) and conveys the substrate W from the first processing module (21a, 21b) to the second processing module (31); a pair of gutters (53, 54) that are disposed above

[続葉有]



WO 2023/084977 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE,
KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

the floor (51) of the conveying area (28) and are connected to a drain line (58); and at least one inclined plate (56) that spans the pair of gutters (53, 54). The upper surface of the inclined plate (56) extends at an angle relative to the horizontal direction, from one of the gutters (53, 54) in the pair to the other.

(57) 要約: 本発明は、基板を処理する基板処理装置に関する。基板処理装置(10)は、液体を使用して基板Wを処理する少なくとも1つの第1処理モジュール(21a, 21b)と、第1処理モジュール(21a, 21b)で処理された後の基板Wを処理する少なくとも1つの第2処理モジュール(31)と、基板Wを第1処理モジュール(21a, 21b)から第2処理モジュール(31)に搬送する、搬送エリア(28)に配置された搬送ロボット(22)と、搬送エリア(28)の床(51)の上方に配置され、ドレインライン(58)に連結された一対の樋(53, 54)と、一対の樋(53, 54)に掛け渡された少なくとも1つの傾斜板(56)と、を備える。傾斜板(56)の上面は、一対の樋(53, 54)の一方から他方まで水平方向に対して傾斜して延びている。